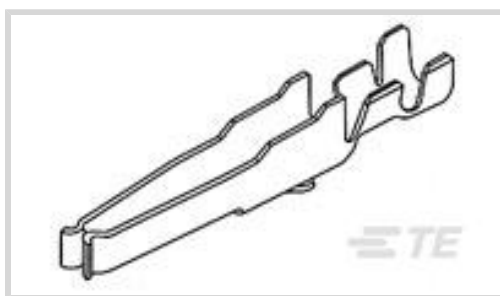




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子接触部电镀材料: **金**

壳体内部的端子定位力: **带有**

壳体内部的端子定位器类型: **卡口**

端子基材: **磷青铜**

产品端接到: **线缆**

## 产品特性

### 接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.75 μm
端子长度	22.2 mm[.87 in]
端子接触部电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

壳体内部的端子定位器类型	卡口
--------------	----

### 尺寸

	2 – 2.5 in
--	------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal

### 包装特性

封装方法	零散零件
------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_166633-2\\_M.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_166633-2\\_M.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_166633-2\\_M.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 产品规格

48 Pos. Receptacle Connector With 1 x 1 mm ACTION PIN Feature

英文版本

## 应用规格

英文版本

166633-2

Gold, Snap-In Contact Retention, Phosphor Bronze, Signal, -67 – 257 °F [-55 – 125 °C]

